

北京赛微电子股份有限公司
2025 年年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

- 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；
- 2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形。

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东 的净利润	盈利：141,444.11 万元～150,377.43 万元	亏损：16,999.41 万元
	比上年同期上升：932%～985%	
扣除非经常性损益 后的净利润	亏损：30,309.83 万元～39,109.45 万元	亏损：19,071.59 万元
	比上年同期下降：59%～105%	
营业收入	80,663.32 万元～83,989.64 万元	120,471.56 万元
扣除后营业收入	76,774.54 万元～79,940.50 万元	114,149.69 万元
基本每股收益	盈利：1.93 元/股～2.05 元/股	亏损：0.23 元/股
MEMS 业务收入	66,820.19 万元～70,264.53 万元	99,804.58 万元

注：“扣除后营业收入”指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告相关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与年报审计会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

本报告期业绩变动的主要原因为：

1、公司于2025年7月完成对原全资子公司Silex Microsystems AB（以下简称“瑞典Silex”）控股权的出售，本次股权交易完成后，瑞典Silex由公司全资子公司转变为公司参股子公司，不再纳入公司合并报表范围，由此产生的非经常性损益对本报告期归属于上市公司股东的净利润产生重大影响；上述股权交易是公司营业收入、MEMS业务收入下降、归属于上市公司股东的净利润大幅增长的主要原因。

2、公司北京MEMS产线（FAB3）的产能爬坡持续推进，除继续开展具有导入属性的工艺开发业务外，从工艺开发阶段转入风险试产、量产阶段的晶圆代工品类持续增加，报告期内北京FAB3工厂实现MEMS硅晶振及OCS（Optical Circuit Switch的缩写，即光链路交换器件）从工艺开发到小批量试生产的推进；但由于部分原有量产客户订单在报告期内因下游市场需求变化产生波动，北京FAB3工厂的收入出现下滑。此外，北京FAB3工厂研发投入依然保持较高强度，运营支出存在刚性，叠加折旧摊销等因素，北京FAB3工厂的亏损较上年扩大，该事项是导致公司扣除非经常性损益后的净利润亏损扩大的主要原因。

3、本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收账款、其他应收款、存货（主要为持有的二手半导体设备）等资产进行减值测试，对发生减值的资产计提资产减值准备，该事项是导致公司扣除非经常性损益后的净利润亏损扩大的重要原因。

4、自2025年7月公司出售瑞典Silex控制权至报告期末，公司仍持有瑞典Silex45.24%股权，由此产生的长期股权投资损益对本报告期归属于上市公司股东的净利润产生正向影响。

5、2025年9月，公司完成对青岛展诚科技有限公司（以下简称“展诚科技”）56.24%股权的收购。本次交易完成后公司合计持有展诚科技61.00%股权，展诚科技成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围，该事项对公司本报告期营业收入、扣除非经常性损益后的净利润产生正向影响。

6、公司本报告期确认瑞典Silex因控股权出让交易触发的大额股权激励费用，导致管理费用大幅增长，剔除该因素影响后，管理费用较上年小幅增加。

7、本报告期内销售费用略有下降、因报告期汇兑损失较上年同期增加导致财务费用增长，同时公司研发费用虽有所下降但继续保持了较高的投入强度。

本报告期内，预计非经常性损益对当期净利润的影响约为181,479.75万元

（主要影响因素为瑞典Silex控股权的出售），上年同期非经常性损益对当期净利润的影响为2,072.18万元（主要影响因素为政府补助）。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2025年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2026年1月27日